

NEW MODEL

高精度加圧・加熱接合装置

HTB-MS/MM



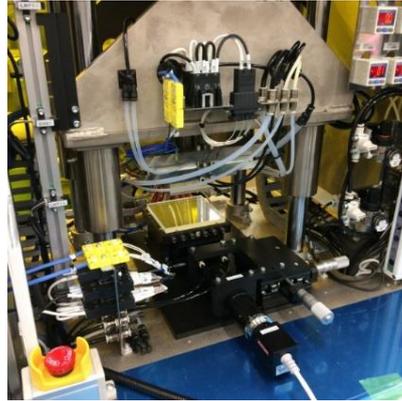
研究所・大学などでの半導体、パワーデバイス、
フィルム材料等の開発に適した、シンプルな
加圧・加熱接合装置です

HTB-MS

★接合観察ユニット(オプション)



1000Nまでの高荷重加圧が可能。
シンタリング開発に最適



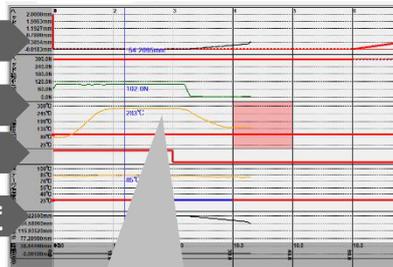
HTB-MM

操作PC画面



5000Nまでの高荷重加圧が可能
大型ステージによりマルチチップ実装が可能

ヘッド位置
荷重
ヘッド温度
ステージ温度



プロフィールと同期した動画

ピックアップした温度・荷重から動画が再生

標準仕様

機種名		高精度加圧・加熱接合装置	
形式	HTB-MS	HTB-MM	
ステージサイズ	□ 30 × 30mm	□ 100 × 100mm	
加熱レンジ(ヘッド)	RT~300°C±15°C(コンスタントヒート。 パルスヒートオプション有)	←	
加熱レンジ(ステージ)	RT~300°C±15°C(コンスタントヒート。 パルスヒートオプション有)	←	
ヘッド加圧力	~500N±5%	501N~5000N±15%	
ヘッド/ステージ間 平行度	±3μm(自動制御オプション有)	±3μm/□20mm, ±20μm/□100mm	
装置サイズ	幅(W)600×奥行(D)600×高さ(H)1550mm (パトライト除く)	←	
重量	約200Kg	約280kg	
動力源	電源	3相 AC200V(50/60Hz) 30A 1系、15A 1系	←
	ドライエア	0.5MPa、245L/min	←
オプション	パルスヒート(ヘッド・ステージ) MAX450°C ヘッド平行度の自動制御システム 接合観察ユニット	パルスヒート(ヘッド・ステージ) MAX450°C (サイズは要打合せ) 接合観察ユニット N2パーージBOX	

お問い合わせは

アルファデザイン株式会社

〒389-0511 長野県東御市滋野甲2211-3
TEL 0268-64-0088 FAX 0268-64-0080
<http://www.alpha-design.co.jp/> seihin@alpha-design.co.jp

- 記載の製品の仕様・外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。
- このカタログの記載内容は2017年1月現在のものです。